

- 【総論】
- I エンジニアリングプラスチック市場・総括
- 1.1 エンブレの位置づけ
 - 1.2 エンブレの市場動向（日本・世界・中国の需要動向）
 - 1.3 各種エンブレの比較
 - 1.4 最近のプラスチック関連の技術動向
 - 1.5 新規ポリマーの開発動向

【樹脂各論】

【エンブレ各論の項目】

- (1) 概要（製法・特徴・物性・メーカー等）
- (2) 市場動向・需要予測（日本、米国、欧州、中国・アジア等の需給動向）
- (3) 分野別市場・用途動向
- (4) 用途例（開発製品の写真と解説）
- (5) 技術開発動向（材料技術、成形技術）
- (6) メーカー各社の生産動向と増産計画

- II 汎用エンジニアリングプラスチック
- 2.1 PC（ポリカーボネート）
 - 2.2 汎用エンブレ系 PA（ポリアミド）
 - 2.3 POM（ポリアセタール）
 - 2.4 PBT（ポリブチレンテレフタレート）
 - 2.5 強化PET（強化ポリエチレンテレフタレート）
 - 2.6 m-PPE（変性ポリフェニレンエーテル）
- III スーパーエンジニアリングプラスチック
- 3.1 FR（フッ素樹脂）
 - 3.2 PPS（ポリフェニレンスルフィド）
 - 3.3 LCP（液晶ポリマー）
 - 3.4 PAR（ポリアリレート）
 - 3.5 PEN（ポリエチレンナフタレート）
 - 3.6 HTPA 高耐熱ポリアミド PA6T PA46、PA9T、PA10T、など
 - 3.7 PSU（ポリスルホン）
 - 3.8 PES（ポリエーテルスルホン）
 - 3.9 PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）
 - 3.10 PEI（ポリエーテルイミド）
 - 3.11 PAI（ポリアミドイミド）
 - 3.12 TPI（熱可塑性ポリイミド）

- 3.13 SPS（シンジオタクチックポリスチレン）

IV エンジニアリングプラスチック周辺材料

- 4.1 LCPA（長鎖脂肪族ポリアミド PA11、PA12、PA1010、PA1012 など）
- 4.2 TPC（ポリエステルエラストマー）
- 4.3 LFT（長繊維強化熱可塑性樹脂）

【メーカー情報】

V メーカー動向（35社）

【メーカー動向の項目例】

- (1) 製品（品揃え）
- (2) 生産・販売体制
- (3) 海外生産・販売拠点
- (4) カスタマーラボ（国内・海外）

旭化成ケミカルズ、旭硝子、ARKEMA、EMS GRIVORY、出光興産、ウインテックポリマー、上野製薬、宇部興産、エムス、クレハ、SABIC IP、JX 日鉱日石エネルギー、住化スタイロンポリカーボネート、住友化学、ソルベイスペシャルティポリマーズ、ダイキン工業、ダイセル・エポニック、ダイセルポリマー、Ticona、DSM、帝人、DIC、DuPont、東ソー、東レ、東レ・デュポン、東洋紡、バイエル、BASF、ビクトレックス、ポリプラスチック、三井化学、三井・デュポンフロロケミカル、三菱エンジニアリングプラスチック、ユニチカ、LANXESS など